

2018-2023年中国IC封测市场竞争现状分析与投资 商机分析预测报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国IC封测市场竞争现状分析与投资商机分析预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/309872309872.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

一、芯片封装技术详解

芯片封装测试是晶圆制造的后道工序。在集成电路在晶圆上制造完成后，封测厂将集成电路封装成可用芯片，并通过检测后即可推向市场。

图：封测环节流程示意图

芯片封装包括以下工序：

（1）晶片切割（Die Saw）

晶片切割的目的是晶圆制程加工完成的晶粒切割分离。切割前先要进行黏片，再送至切割机切割。切割完成后晶粒有序排列在胶带上，框架支撑避免胶带的皱褶和晶粒相互碰撞。

（2）连线与封胶

芯片通过封胶保护，并引线与外接电路相连。

（3）测试

封装环节的测试包括生产测试、老化测试、出厂测试等。

生产测试是芯片封装后，对成品进行的全面电测试。老化测试分静态和动态。静态老化测试是在给器件提供供电电压的情况下，提高器件的工作温度，对其寿命进行测试；动态测试则是在静态的基础上施加激励。出厂测试对出厂器件进行抽检，确保其合格率。

封装技术经过多年的发展，已经过五代技术变革：

图：封装技术变革历程表：各代封装技术一览

二、我国封测企业已跻身全球前列

我国封测企业经过多年的发展，已取得了不小成绩。长电科技、华天科技、通富微电等领先厂家经过多年发展，已跻身全球前十大封测厂家行列。尤其是长电科技，收购了新加

坡星科金朋后，已成为全球第三大封测厂家。

表：全球前十大封测厂家排名

观研天下发布的《2018-2023年中国IC封测市场竞争现状分析与投资商机分析预测报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一章行业发展综述

1.1 IC封测行业定义及分类

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业产品/服务分类

1.1.3 行业主要商业模式

1.2 IC封测行业特征分析

1.2.1 产业链分析

1.2.2 IC封测行业在产业链中的地位

1.2.3 IC封测行业生命周期分析

(1) 行业生命周期理论基础

(2) IC封测行业生命周期

1.3 最近3-5年中国IC封测行业经济指标分析

1.3.1 赢利性

1.3.2 成长速度

1.3.3 附加值的提升空间

1.3.4 进入壁垒 / 退出机制

1.3.5 风险性

1.3.6 行业周期

1.3.7 激烈程度指标

1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析

第二章 IC封测行业运行环境（PEST）分析

2.1 IC封测行业政治法律环境分析

2.1.1 行业管理体制分析

2.1.2 行业主要法律法规

2.1.3 行业相关发展规划

2.2 IC封测行业经济环境分析

2.2.1 国际宏观经济形势分析

2.2.2 国内宏观经济形势分析

2.2.3 产业宏观经济环境分析

2.3 IC封测行业社会环境分析

2.3.1 IC封测产业社会环境

2.3.2 社会环境对行业的影响

2.3.3 IC封测产业发展对社会发展的影响

2.4 IC封测行业技术环境分析

2.4.1 IC封测技术分析

2.4.2 IC封测技术发展水平

2.4.3 行业主要技术发展趋势

第三章 我国IC封测行业运行分析

3.1 我国IC封测行业发展状况分析

3.1.1 我国IC封测行业发展阶段

3.1.2 我国IC封测行业发展总体概况

3.1.3 我国IC封测行业发展特点分析

3.2 2016-2017年IC封测行业发展现状

3.2.1 2016-2017年我国IC封测行业市场规模

3.2.2 2016-2017年我国IC封测行业发展分析

3.2.3 2016-2017年中国IC封测企业发展分析

3.3 区域市场分析

3.3.1 区域市场分布总体情况

3.3.2 2016-2017年重点省市市场分析

3.4 IC封测细分产品/服务市场分析

3.4.1 细分产品/服务特色

3.4.2 2016-2017年细分产品/服务市场规模及增速

3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测

3.5 IC封测产品/服务价格分析

3.5.1 2016-2017年IC封测价格走势

3.5.2 影响IC封测价格的关键因素分析

(1) 成本

(2) 供需情况

(3) 关联产品

(4) 其他

3.5.3 2018-2023年IC封测产品/服务价格变化趋势

3.5.4 主要IC封测企业价位及价格

第四章 我国IC封测行业整体运行指标分析

4.1 2016-2017年中国IC封测行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

4.1.2 人员规模状况分析

4.1.3 行业资产规模分析

4.1.4 行业市场规模分析

4.2 2016-2017年中国IC封测行业运营情况分析

4.2.1 我国IC封测行业营收分析

4.2.2 我国IC封测行业成本分析

4.2.3 我国IC封测行业利润分析

4.3 2016-2017年中国IC封测行业财务指标总体分析

4.3.1 行业盈利能力分析

4.3.2 行业偿债能力分析

4.3.3 行业营运能力分析

4.3.4 行业发展能力分析

第五章 我国IC封测行业供需形势分析

5.1 IC封测行业供给分析

5.1.1 2016-2017年IC封测行业供给分析

5.1.2 2018-2023年IC封测行业供给变化趋势

5.1.3 IC封测行业区域供给分析

5.2 2016-2017年我国IC封测行业需求情况

5.2.1 IC封测行业需求市场

5.2.2 IC封测行业客户结构

5.2.3 IC封测行业需求的地区差异

5.3 IC封测市场应用及需求预测

5.3.1 IC封测应用市场总体需求分析

(1) IC封测应用市场需求特征

(2) IC封测应用市场需求总规模

5.3.2 2018-2023年IC封测行业领域需求量预测

(1) 2018-2023年IC封测行业领域需求产品/服务功能预测

(2) 2018-2023年IC封测行业领域需求产品/服务市场格局预测

5.3.3 重点行业IC封测产品/服务需求分析预测

第六章 IC封测行业产业结构分析

6.1 IC封测产业结构分析

6.1.1 市场细分充分程度分析

6.1.2 各细分市场领先企业排名

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例

6.1.4 领先企业的结构分析(所有制结构)

6.2 产业价值链的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

6.2.1 产业价值链的构成

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

6.3 产业结构发展预测

6.3.1 产业结构调整指导政策分析

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素

6.3.3 中国IC封测行业参与国际竞争的市场定位

6.3.4 IC封测产业结构调整方向分析

第七章 我国IC封测行业产业链分析

7.1 IC封测行业产业链分析

7.1.1 产业链结构分析

7.1.2 主要环节的增值空间

7.1.3 与上下游行业之间的关联性

7.2 IC封测上游行业分析

7.2.1 IC封测产品成本构成

7.2.2 2016-2017年上游行业发展现状

7.2.3 2018-2023年上游行业发展趋势

7.2.4 上游供给对IC封测行业的影响

7.3 IC封测下游行业分析

7.3.1 IC封测下游行业分布

7.3.2 2016-2017年下游行业发展现状

7.3.3 2018-2023年下游行业发展趋势

7.3.4 下游需求对IC封测行业的影响

第八章 我国IC封测行业渠道分析及策略

8.1 IC封测行业渠道分析

8.1.1 渠道形式及

8.1.2 各类渠道对IC封测行业的影响

8.1.3 主要IC封测企业渠道策略研究

8.1.4 各区域主要代理商情况

8.2 IC封测行业用户分析

8.2.1 用户认知程度分析

8.2.2 用户需求特点分析

8.2.3 用户购买途径分析

8.3 IC封测行业营销策略分析

8.3.1 中国IC封测营销概况

8.3.2 IC封测营销策略探讨

8.3.3 IC封测营销发展趋势

第九章 我国IC封测行业竞争形势及策略

9.1 行业总体市场竞争状况分析

9.1.1 IC封测行业竞争结构分析

(1) 现有企业间竞争

(2) 潜在进入者分析

(3) 替代品威胁分析

(4) 供应商议价能力

(5) 客户议价能力

(6) 竞争结构特点总结

9.1.2 IC封测行业企业间竞争格局分析

9.1.3 IC封测行业集中度分析

9.1.4 IC封测行业SWOT分析

9.2 中国IC封测行业竞争格局综述

9.2.1 IC封测行业竞争概况

- (1) 中国IC封测行业竞争格局
- (2) IC封测行业未来竞争格局和特点
- (3) IC封测市场进入及竞争对手分析

9.2.2 中国IC封测行业竞争力分析

- (1) 我国IC封测行业竞争力剖析
- (2) 我国IC封测企业市场竞争的优势
- (3) 国内IC封测企业竞争能力提升途径

9.2.3 IC封测市场竞争策略分析

第十章 IC封测行业领先企业经营形势分析

10.1 日月光公司

10.1.1 企业概况

10.1.2 企业优势分析

10.1.3 产品/服务特色

10.1.4 2016-2017年经营状况

10.1.5 2018-2023年发展规划

10.2 艾克尔公司

10.2.1 企业概况

10.2.2 企业优势分析

10.2.3 产品/服务特色

10.2.4 2016-2017年经营状况

10.2.5 2018-2023年发展规划

10.3 矽品公司

10.3.1 企业概况

10.3.2 企业优势分析

10.3.3 产品/服务特色

10.3.4 2016-2017年经营状况

10.3.5 2018-2023年发展规划

10.4 星科金朋公司

10.4.1 企业概况

10.4.2 企业优势分析

10.4.3 产品/服务特色

10.4.4 2016-2017年经营状况

10.4.5 2018-2023年发展规划

10.5 力成公司

10.5.1 企业概况

10.5.2 企业优势分析

10.5.3 产品/服务特色

10.5.4 2016-2017年经营状况

10.5.5 2018-2023年发展规划

10.6 长电科技公司

10.6.1 企业概况

10.6.2 企业优势分析

10.6.3 产品/服务特色

10.6.4 2016-2017年经营状况

10.6.5 2018-2023年发展规划

第十一章 2018-2023年IC封测行业投资前景

11.1 2018-2023年IC封测市场发展前景

11.1.1 2018-2023年IC封测市场发展潜力

11.1.2 2018-2023年IC封测市场发展前景展望

11.1.3 2018-2023年IC封测细分行业发展前景分析

11.2 2018-2023年IC封测市场发展趋势预测

11.2.1 2018-2023年IC封测行业发展趋势

11.2.2 2018-2023年IC封测市场规模预测

11.2.3 2018-2023年IC封测行业应用趋势预测

11.2.4 2018-2023年细分市场发展趋势预测

11.3 2018-2023年中国IC封测行业供需预测

11.3.1 2018-2023年中国IC封测行业供给预测

11.3.2 2018-2023年中国IC封测行业需求预测

11.3.3 2018-2023年中国IC封测供需平衡预测

11.4 影响企业生产与经营的关键趋势

11.4.1 市场整合成长趋势

11.4.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测

11.4.3 企业区域市场拓展的趋势

11.4.4 科研开发趋势及替代技术进展

11.4.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章 2018-2023年IC封测行业投资机会与风险

12.1 IC封测行业投融资情况

12.1.1 行业资金渠道分析

12.1.2 固定资产投资分析

12.1.3 兼并重组情况分析

12.2 2018-2023年IC封测行业投资机会

12.2.1 产业链投资机会

12.2.2 细分市场投资机会

12.2.3 重点区域投资机会

12.3 2018-2023年IC封测行业投资风险及防范

12.3.1 政策风险及防范

12.3.2 技术风险及防范

12.3.3 供求风险及防范

12.3.4 宏观经济波动风险及防范

12.3.5 关联产业风险及防范

12.3.6 产品结构风险及防范

12.3.7 其他风险及防范

第十三章 IC封测行业投资战略研究

13.1 IC封测行业发展战略研究

13.1.1 战略综合规划

13.1.2 技术开发战略

13.1.3 业务组合战略

13.1.4 区域战略规划

13.1.5 产业战略规划

13.1.6 营销品牌战略

13.1.7 竞争战略规划

13.2 对我国IC封测品牌的战略思考

13.2.1 IC封测品牌的重要性

13.2.2 IC封测实施品牌战略的意义

13.2.3 IC封测企业品牌的现状分析

13.2.4 我国IC封测企业的品牌战略

13.2.5 IC封测品牌战略管理的策略

13.3 IC封测经营策略分析

13.3.1 IC封测市场细分策略

- 13.3.2 IC封测市场创新策略
- 13.3.3 品牌定位与品类规划
- 13.3.4 IC封测新产品差异化战略
- 13.4 IC封测行业投资战略研究
 - 13.4.1 2017年IC封测行业投资战略
 - 13.4.2 2018-2023年IC封测行业投资战略
 - 13.4.3 2018-2023年细分行业投资战略

第十四章 研究结论及投资建议

- 14.1 IC封测行业研究结论
- 14.2 IC封测行业投资价值评估
- 14.3 IC封测行业投资建议
 - 14.3.1 行业发展策略建议
 - 14.3.2 行业投资方向建议
 - 14.3.3 行业投资方式建议

图表目录：

- 图表1：IC封测行业生命周期
- 图表2：IC封测行业产业链结构
- 图表3：2016-2017年全球IC封测行业市场规模
- 图表4：2016-2017年中国IC封测行业市场规模
- 图表5：2016-2017年IC封测行业重要数据指标比较
- 图表6：2016-2017年中国IC封测市场占全球份额比较
- 图表7：2016-2017年IC封测行业工业总产值
- 图表8：2016-2017年IC封测行业销售收入
- 图表9：2016-2017年IC封测行业利润总额
- 图表10：2016-2017年IC封测行业资产总计
- 图表11：2016-2017年IC封测行业负债总计
- 图表12：2016-2017年IC封测行业竞争力分析
- 图表13：2016-2017年IC封测市场价格走势
- 图表14：2016-2017年IC封测行业主营业务收入
- 图表15：2016-2017年IC封测行业主营业务成本
- 图表16：2016-2017年IC封测行业销售费用分析
- 图表17：2016-2017年IC封测行业管理费用分析

图表18：2016-2017年IC封测行业财务费用分析

图表19：2016-2017年IC封测行业销售毛利率分析

图表20：2016-2017年IC封测行业销售利润率分析

图表21：2016-2017年IC封测行业成本费用利润率分析

图表22：2016-2017年IC封测行业总资产利润率分析

图表23：2016-2017年IC封测行业集中度

图表24：2018-2023年中国IC封测行业供给预测

图表25：2018-2023年中国IC封测行业需求预测

图表26：2018-2023年中国IC封测行业市场容量预测

图表详见报告正文（BGZQJP）

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/309872309872.html>